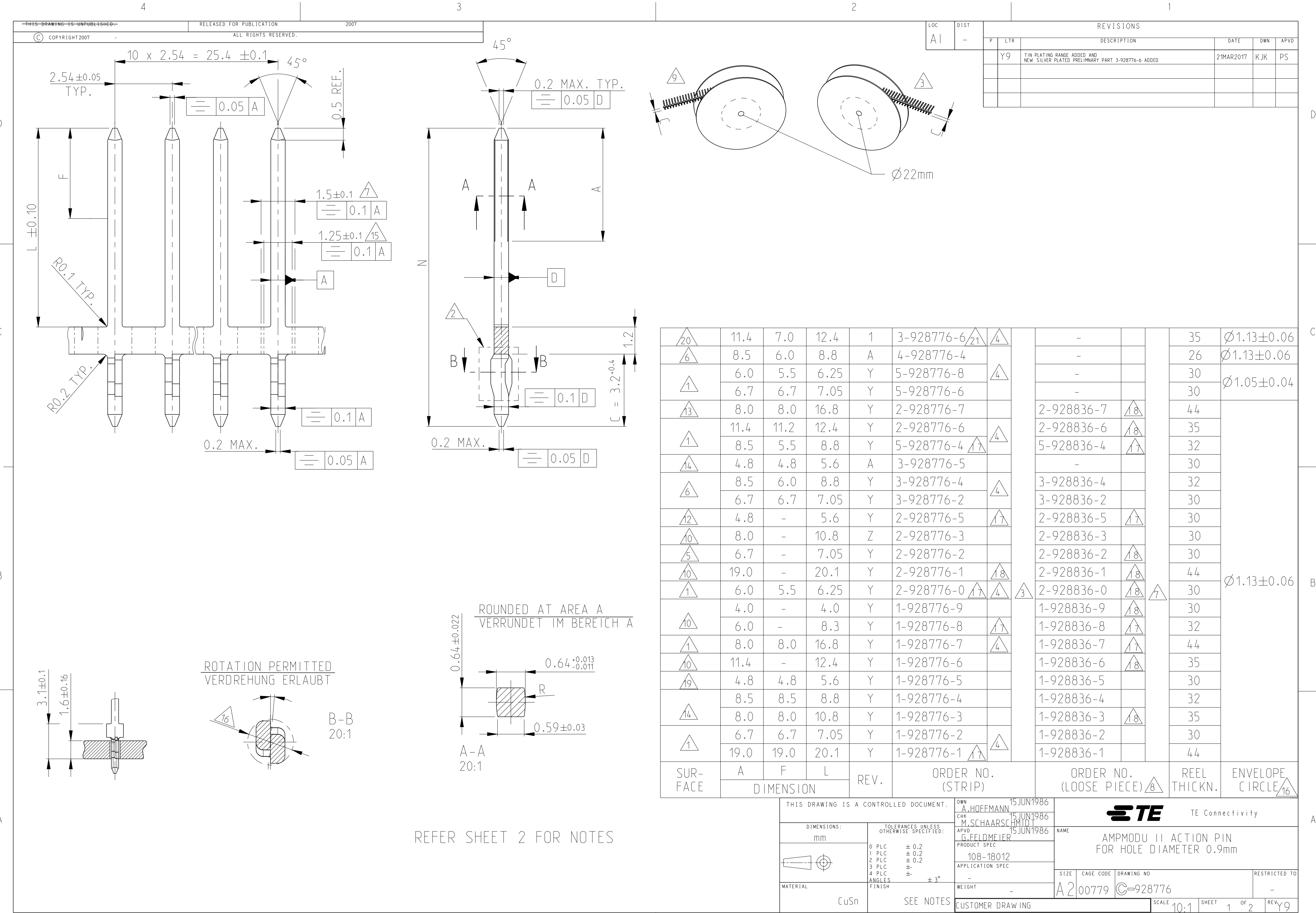




4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2007

© COPYRIGHT 2007

-

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

A

I

-

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

-

SEE SHEET 1

-

-

-

NOTES:

1

AT AREA F MIN 0.8 µm GOLD OVER MIN 1.2 µm NICKEL AT AREA N;
AT AREA C 3.0 -6.0 µm TIN OVER MIN 1.2 µm NICKEL

2

PRESS-IN AREA FOR 1.6mm PCB
REQUIREMENTS FOR PCB HOLE

PLATED HOLE:
DRILL-Ø: 1.0 ±0.025
Cu-THICKN.: 25 - 50 µm
Sn-THICKN.: 4 - 10 µm
FINISHED HOLE-Ø: 0.9 ±0.07

UNPLATED HOLE:
DRILL-Ø: 1.0 ±0.025
FOR SOLDER APPLICATION

ALTERNATIVE-PLATING:
Cu-THICKN.: 25 - 50 µm
Ni-THICKN.: 1.3 - 5 µm
Au-THICKN.: 0.05 - 0.2 µm

93

REEL UNIT 50.000 PIECES. REEL-Ø 600mm / Ø588mm
REEL THICKNESS SEE TABLE

4

SOLDERABILITY ACC. TO IEC 60068 - 2 - 20; TEST Ta

5

AT AREA N 3.0-6.0 µm TIN OVER MIN 1.2 µm NICKEL

6

AT AREA F 1-2 µm TIN; AT AREA C 3.0-6.0 µm TIN
OVER MIN 1.2 µm NICKEL

157

CUT AREA FOR LOOSE PIECE PARTS DURING THE STITCHING INTO PCB
DIMENSION IS DETERMINED BY THE TOOL OF THE STITCHING MACHINE

8

1000 PIECES ARE PACKED INTO SHOCK-PROOF BOX
AND CLOSED WITH COVER

10

AT AREA N MIN. 2.5 µm TIN OVER MIN 1.2 µm NICKEL

12

AT AREA N 1-2 µm TIN OVER MIN 1.2 µm NICKEL

13

AT AREA F 2-4 µm TIN OVER MIN 1.2 µm NICKEL AT AREA N;
AT AREA C MIN. 1.2 µm TIN OVER MIN 1.2 µm NICKEL

14

AT AREA F MIN 0.8 µm GOLD OVER MIN 1.2 µm NICKEL AT AREA N;
AT AREA C 1.3-2.5 µm TIN OVER MIN 1.2 µm NICKEL

17

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

18

OBSOLETE

19

AT AREA F MIN. 1.2 µm GOLD OVER MIN 1.2 µm NICKEL AT AREA N;
AT AREA C 1.3-2.5 µm TIN OVER MIN 1.2 µm NICKEL

20

AT AREA F 1.5-5.0 µm SILVER (WEIGHT% ≥98.0) OVER MIN 1.2 µm NICKEL AT AREA N
AT AREA C 3.0-6.0 µm TIN OVER MIN 1.2 µm NICKEL

21

PRELIMINARY PART

1

IM BEREICH F MIN. 0.8 µm GOLD ÜBER MIN. 1.2 µm NICKEL IM BEREICH N;
IM BEREICH C 3.0-6.0 µm ZINN ÜBER MIN. 1.2 µm NICKEL

2

EINPRESSZONE FÜR 1.6mm LEITERPLATTE
ANFORDERUNG AN DIE LEITERPLATTENBOHRUNG

PLATTIERTES LOCH:
BOHR-Ø: 1.0 ±0.025
Cu-DICKE: 25 - 50 µm
Sn-DICKE: 4 - 10 µm
FERTIGLOCH-Ø: 0.9 ±0.07

NICHT PLATTIERTES LOCH:
BOHR-Ø: 1.0 ±0.025
ZUM LÖTEN

ALTERNATIV-PLATING:
Cu-DICKE: 25 - 50 µm
Ni-DICKE: 1.3 - 5 µm
Au-DICKE: 0.05 - 0.2 µm

93

ROLLENEINHEIT 50.000 STIFTE. ROLLEN-Ø 600mm / Ø588mm
ROLLENDICKE SIEHE TABELLE

4

LÖTBARKEIT NACH IEC 60068 - 2 - 20; PRÜFUNG Ta

5

IM BEREICH N 3.0-6.0 µm ZINN ÜBER MIN. 1.2 µm NICKEL

6

IM BEREICH F 1-2 µm ZINN; IM BEREICH C 3.0-6.0 µm ZINN
ÜBER JE MIN. 1.2 µm NICKEL

157

SCHNITTSTELLE FÜR EINZELSTIFT BEIM EINSETZEN IN PCB
MAß IST DURCH WERKZEUG AN DER JEWELIGEN
EINSETZMASCHINE VORGEGEBEN

8

1000 STIFTE IN STOßSICHERE SCHACHTEL VERPACKT
UND MIT DECKEL VERSCHLOSSEN

10

IM BEREICH N MIN. 2.5 µm ZINN ÜBER MIN. 1.2 µm NICKEL

12

IM BEREICH N 1-2 µm ZINN ÜBER MIN. 1.2 µm NICKEL

13

IM BEREICH F 2-4 µm ZINN ÜBER 1.2 µm NICKEL IM BEREICH N;
IM BEREICH C MIN. 1.2 µm ZINN ÜBER MIN. 1.2 µm NICKEL

14

IM BEREICH F MIN. 0.8 µm GOLD ÜBER MIN. 1.2 µm NICKEL IM BEREICH N;
IM BEREICH C 1.3-2.5 µm ZINN ÜBER MIN. 1.2 µm NICKEL

17

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

18

OBSOLETE

19

IM BEREICH F MIN. 1.2 µm GOLD ÜBER MIN. 1.2 µm NICKEL IM BEREICH N;
IM BEREICH C 1.3-2.5 µm ZINN ÜBER MIN. 1.2 µm NICKEL

20

IM BEREICH F 1.5-5.0 µm SILBER (GEWICHT% ≥98.0) ÜBER MIN 1.2 µm NICKEL IM BEREICH N;
IM BEREICH C 3.0-6.0 µm ZINN ÜBER MIN. 1.2 µm NICKEL

21

VORLÄUFIGER TEIL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:

mm

MATERIAL

CuSn

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± 0.2
1 PLC ± 0.2
2 PLC ± 0.2
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ± 3°
FINISH

SEE NOTES

DWN

A.HOFFMANN

15 JUN 1986

CHK

M.SCHAARSCHMIDT

15 JUN 1986

APVD

G.FELDMEIER

15 JUN 1986

PRODUCT SPEC

108-18012

APPLICATION SPEC

-

WEIGHT

-

CUSTOMER DRAWING

NAME

AMPMODU II ACTION PIN
FOR HOLE DIAMETER 0.9mm

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A2

100779

©928776

-

SCALE

10:1

SHEET

2

OF

2

REV

Y9

1471-9 (3/11)